

応用物理学会集積化MEMS技術研究会主催

## 第2回 集積化MEMS技術研究会 プログラム

- 【開催日時】 平成20年11月21日(金) 9:30~17:50
- 【開催会場】 東京大学生産技術研究所 An棟4階、中セミナー室 (An-401, An-402)
- 【講演プログラム】
- 9:30 - 9:35 委員長 開会挨拶
- 9:35 - 10:20 招待講演 「More than Moore と MEMS」  
河村誠一郎 株式会社 半導体先端テクノロジーズ (Selete)
- 10:20- 10:40 「身体活動モニタ用集積化MEMS」  
○前中一介、兵庫県立大学/(独)科学技術振興機構
- 10:40- 11:00 「2軸変位楕形電極の電気等価回路モデルを用いた静電容量型MEMSの特性解析」  
○土屋智由<sup>1</sup>、細木真保<sup>2</sup>、藤原信代<sup>3</sup>、望月俊輔<sup>4</sup>、橋口原<sup>2</sup>  
京都大学<sup>1</sup>、静岡大学<sup>2</sup>、みずほ情報総研<sup>3</sup>、数理システム<sup>4</sup>
- 11:10- 12:00 MEMS系クリンルーム見学会
- 12:00- 13:00 昼食(各自)
- 13:10 -13:55 招待講演 「MEMSによる異機能集積プロセス」  
藤田博之 東京大学生産技術研究所 マイクロメカトロニクス国際研究センター
- 13:55 -14:15 「真空気密 / 実圧気密方式によるウェーハレベルMEMSパッケージ技術」  
○下岡義明、井上道信、遠藤光芳、小幡進、小島章弘、宮城武史、杉崎吉昭、森郁夫、柴田英毅  
(株)東芝 セミコンダクター社 半導体研究センター
- 14:15 -14:35 「低損失MEMS LC共振器とRF回路との集積化」  
○桑原啓<sup>1</sup>、佐藤昇男<sup>1</sup>、森村浩季<sup>1</sup>、小館淳一<sup>1</sup>、石井仁<sup>1</sup>、亀井敏和<sup>2</sup>、町田克之<sup>2</sup>、佐藤康博<sup>1</sup>  
NTT<sup>1</sup>、NTT AT<sup>2</sup>
- 14:35 -14:55 「LSIへの単結晶シリコン貼り付けによるRF MEMSスイッチの作製法」  
○中村慎吾、江刺正喜、田中秀治、東北大学
- 14:55 -15:10 Coffee Break
- 15:10 -15:30 「MEMSデバイスのパッケージングにおける保護・封止技術の検討」  
○真弓功人<sup>1</sup>、千野満<sup>1</sup>、田澤浩<sup>1</sup>、島田照男<sup>1</sup>、亀井敏和<sup>2</sup>、矢野正樹<sup>2</sup>、町田克之<sup>2</sup>、佐藤昇男<sup>3</sup>、  
桑原啓<sup>3</sup>、石井仁<sup>3</sup>、日暮栄治<sup>4</sup>、ミスズ工業<sup>1</sup>、NIT-AT<sup>2</sup>、NIT<sup>3</sup>、東京大学<sup>4</sup>
- 15:30 -15:50 「集積化CMOS-MEMSに向けたMEMS可動構造の位置制御容量検出方法」  
○島村俊重<sup>1</sup>、森村浩季<sup>1</sup>、桑原啓<sup>1</sup>、佐藤昇男<sup>1</sup>、町田克之<sup>2</sup>、NIT<sup>1</sup>、NTT AT<sup>2</sup>
- 15:50 -16:10 「コンビナトリアル技術と集積化MEMS」  
○秦誠一<sup>1</sup>、青野裕子<sup>2</sup>、桜井淳平<sup>1</sup>、東京工業大学 精密工学研究所<sup>1</sup>、総合理工学研究科<sup>2</sup>
- 16:10 -16:30 「MEMSデバイスのための微小構造部材—基板間のはく離強度に関する研究」  
○石山千恵美、柴田暁伸、曾根正人、肥後矢吉、東京工業大学 精密工学研究所
- 16:30 -16:50 「SOI-MEMS構造へのC<sub>60</sub>ナノワイヤの集積化及び静電容量型引張試験デバイスの製作」  
○浦靖武、菅野公二、土屋智由、田畑修、京都大学
- 16:50 -17:10 「機能積層型の集積化DNA解析チップの作製」  
○大向智也、福岡大翼、内海祐一、兵庫県立大学 高度産業科学技術研究所
- 17:10 -17:30 「SOI CMOS-MEMSにおけるMEMSポストプロセスの信頼性評価」  
○高橋一浩、藤田博之、年吉洋、東京大学 生産技術研究所
- 17:30 -17:50 「柔らかいシリコンマイクロ構造物とその神経信号解析への応用」  
○金俊亨、久保田正則、肥後昭男、三田吉郎、東京大学工学部 先端知機能材料デバイスラボラトリーズ
- 【懇親会】
- 18:00 - 19:30 研究会参加者による懇親会(会場:東京大学生産技術研究所内、会費:3000円)
- 【問合せ先】 年吉洋、東京大学 生産技術研究所  
TEL:03-5452-6276, FAX: 03-5452-6648, E-mail: hiro@iis.u-tokyo.ac.jp